

广东依顿电子科技股份有限公司

（注册地址：广东省中山市三角镇高平工业区）



2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年八月

一、本次发行募集资金的使用计划

公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 200,000.00 万元，扣除相关发行费用后的净额将用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 金额（万元）
1	高端印制电路板智能制造项目	297,877.93	185,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计	合计	312,877.93	200,000.00

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目基本情况

（一）高端印制电路板智能制造项目

1、项目基本情况

项目围绕市场高端印制电路板需求，建设高端高速高多层 PCB 智能制造项目。项目拟利用依顿电子中山现有园区土地，新建专业化生产厂房，配套实施基建工程、厂房装修、设备购置安装、公辅配套、废水处理、危化品安全管理、仓储物流及数字化管理系统建设，形成面向高端算力硬件的印制电路板规模化制造能力。

项目产品主要定位于高多层板（HLC）和高阶高密度互连板（HDI），重点面向服务器、高速交换机、路由器、加速卡、计算托盘主板、通信设备等应用场景，并预留光模块相关产品生产空间。项目达产后，规划形成高端印制电路板年产能 40 万平方米，预计实际达产峰值可达 43.5 万平方米/年。其中，高

多层板规划年产能 34 万平方米，高阶 HDI 板规划年产能 6 万平方米。

围绕上述产品方向，项目将配置满足高层数、高密度、高可靠性 PCB 生产要求的关键工序设备，重点增强高端高速 PCB 在多层压合、精细线路、钻孔加工、湿制程处理、过程检测和质量追溯等环节的制造能力。项目建成后，将进一步完善依顿电子面向算力基础设施、高性能计算设备和高端通信装备的产品供给体系，支撑公司产品结构向高技术含量、高附加值方向升级。

项目计划总投资 297,877.93 万元，其中硬件设备购置费 179,478.52 万元，软件购置费 15,786.00 万元，厂房建设费用 55,064.25 万元，开发费用 4,477.50 万元，预备费 38,220.94 万元，铺底流动资金 4,850.72 万元。

2、项目效益分析

本项目投资内部收益率为 13.01%（所得税后），经济技术指标良好。税后投资回收期为 8.51 年（含建设期），税后财务净现值为 57,484.15 万元。综合来看，本项目具备较好的经济效益。

3、项目审批备案情况

本项目实施已经取得的审批备案文件如下：

项目	文件	颁发单位
项目备案	广东省企业投资项目备案证（2606-442000-04-01-259714）	中山市发展和改革局
环评批复	正在办理中	中山市生态环境局
土地/规划	利用现有土地，无需新增建设用地	--

（二）补充流动资金项目

公司拟将本次募集资金中 15,000.00 万元用于补充流动资金，满足公司日常生产经营资金需求，进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力。

三、本次募集资金投资项目的必要性

（一）高端印制电路板智能制造项目

1、项目建设是落实企业和集团战略布局、提升长期发展质量的需要

依顿电子作为九洲集团体系内上市公司，承担着推动 PCB 业务升级、完善高端电子制造布局和提升资产质量的重要任务。公司已在汽车电子、传统通信等领域形成较好基础，但面对高性能计算和高速通信带来的产业结构调整，需要进一步拓展面向未来增长领域的业务布局。

项目建设有助于公司从传统 PCB 制造向高端智能硬件配套领域延伸，推动公司在高端高速高多层板、高阶 HDI 板等方向形成新的业务增长基础，提升产品附加值和市场空间，增强企业在集团高端电子制造体系中的支撑作用。

2、项目建设是顺应高端算力和高速通信硬件升级的需要

随着高性能计算和高速通信设备等产业的加快发展，正在推动 PCB 产品需求向高层数、高密度、高速低损耗和高可靠方向升级。新产品对 PCB 材料损耗、信号完整性、阻抗控制、孔结构精度和长期可靠性提出更高要求。传统常规多层板和普通 HDI 产品，已难以充分满足高端硬件持续迭代的配套需求。依顿电子长期深耕 PCB 制造领域，在汽车电子、通信设备等领域积累了较好的生产经验和客户基础。

公司需要围绕高多层板、高阶 HDI 板等方向提升产品供给能力，进一步适应新兴市场需求，有助于公司把握高端 PCB 需求增长窗口，增强对高端硬件客户的配套能力，为公司进入更高技术层级和更高附加值应用领域提供支撑。

3、项目建设是补齐高端 PCB 产能和工艺平台短板的需要

高端算力硬件和高速通信设备对 PCB 产品提出了更高要求，相关产品逐步向高层数、高密度、高速低损耗和高可靠方向演进。随着客户需求向高多层板、高阶 HDI 板和高速低损耗产品迁移，现有产能结构难以完全满足未来高端产品导入、样品验证和规模化交付需求。

项目通过新建专业化智能制造工厂，配置适配高端高速 PCB 生产的厂房空间、关键设备、工艺系统、公辅环保设施和数字化管理平台，能够补齐公司高多层板、高阶 HDI 板等高端产品的产能和工艺平台短板。项目建设有助于企业形成与客户需求相匹配的规模化承接能力，提升高端 PCB 产品的供应稳定性和批量交付能力。

4、项目建设是增强客户协同和供应链响应能力的需要

高端 PCB 客户对供应商的要求已从单一价格和产能，延伸到研发协同、样品响应、审厂认证、质量追溯、数据安全、环保合规和持续改善等综合能力。随着客户产品向高速交换机、卫星通信等高端领域方向升级，客户对高端 PCB 供应商的本地化响应、工程支持和稳定交付能力提出更高要求。原有常规产线和传统厂房条件，难以完全满足高端客户在样品验证、审厂认证、小批量导入和批量交付方面的要求。

项目建设能够进一步提升依顿电子与重点客户之间的协同深度，特别是在高端 PCB 交期较长、客户希望增加合格供应商资源的背景下，项目建设有助于公司提高供应链参与度和客户服务能力。

5、项目建设是推动企业智能制造和质量管理体系升级的需要

高端 PCB 产品制造工序长、质量控制点多，对全过程数据管理、质量追溯和异常闭环能力要求较高。高端领域等应用场景对产品可靠性、一致性和长期稳定性要求较高，客户审厂过程中通常会重点关注生产现场管理、质量体系、数据追溯、环保合规和交付稳定性。传统经验型生产管理方式难以充分满足高端客户对过程透明、参数可控和质量可追溯的要求。

项目建设不仅形成新增高端产能，也将带动企业制造体系、质量体系和运营管理能力整体升级。对于依顿电子而言，智能制造和质量管理能力提升将直接支撑客户认证、良率爬坡和批量交付，也有助于企业在高端电子制造竞争中形成更稳定的长期能力。

（二）补充流动资金项目

1、公司的业务拓展需要保持较高的资金投入水平

随着公司业务的高速发展，公司在手订单的逐步执行，同时考虑募投项目实施等因素的影响，公司未来营业收入的增长将对营运资金产生较大需求。本次募集资金中部分资金用于补充流动资金，为公司运营资本提供稳定的资金来源，增强公司的可持续盈利能力。

2、为推进公司十五五战略发展规划提供资金保障

“十四五”期间，公司稳步实施各项发展战略和经营计划，深耕汽车电子、计算与通信、工控医疗、新能源及电源、多媒体与显示等五大应用领域，实现

了经营业绩的稳步增长。面向“十五五”时期，全球 PCB 行业正经历以算力、新能源汽车、通信为驱动力的结构性变革，公司重点布局高端高速高多层和高阶 HDI 赛道，抢占算力、高性能计算和卫星通信等高端应用领域的机遇。公司将持续加大市场纵深发展和横向拓展力度，通过新客户的开拓助力公司的发展。未来，公司将继续加大投入资源推进各项业务战略布局，不断提升公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展。本次发行股份补充流动资金将为公司业务战略布局的顺利实施和稳步推进提供有力的资金保障。

四、本次募集资金投资项目的可行性

（一）高端印制电路板智能制造项目

1、市场开拓和客户导入已具备可行性

依顿电子长期服务通信设备、汽车电子、服务器及相关电子终端客户，在 PCB 制造领域形成了一定客户资源基础和市场服务经验。围绕项目建设，公司前期已组织专项工作组开展多轮市场调研和客户沟通，与行业机构、专家及重点客户围绕高端 PCB 市场需求、产品技术方向、供应链导入和新工厂建设等事项进行交流，为项目产品定位和市场导入提供了较为直接的需求支撑。同时，依顿电子已有客户合作基础、样品验证基础和前端客户沟通渠道，为项目建成后进一步推进高端客户导入、审厂认证和批量供货创造了条件。

公司结合客户结构和市场拓展方向，形成了存量客户升级与增量战略客户开拓相结合的产能消化思路，一方面承接既有客户由传统通信设备向高端设备升级带来的订单需求，另一方面分层拓展云计算、服务器、ODM 及海外算力相关客户。

总体来看，项目并非脱离客户基础进行新领域试探，而是在既有客户关系和市场调研基础上，面向高端 PCB 需求变化进行能力延伸，具备较好的市场承接条件。

2、产品定位和技术工艺基础已具备可行性

项目产品方向聚焦高端应用领域，重点布局高端高速高多层板和高阶 HDI 板，从产品导入基础看，依顿电子已有通信和汽车电子 PCB 制造经验，部分产品和客户需求与高端高速 PCB 方向具备延展关系。原有通信类产品、小批量验

证产品及客户样品认证工作，为公司向高多层、高密度产品升级提供了一定基础。项目产品组合中，高多层板和高阶 HDI 板在材料适配、压合、钻孔、电镀、线路制作、阻抗控制、质量追溯等方面具有一定技术共性，有利于形成工艺经验复用和产线能力协同。通过分阶段导入不同技术难度产品，项目具备从现有产品基础向高端 PCB 业务逐步拓展的实施条件。

依顿电子已经在板件制造、工艺管理、质量控制和批量生产方面形成一定经验积累。在高多层板和 HDI 相关产品方面已积累一定运营经验，并围绕 Pinlam、背钻 Stub 控制、信号完整性管理、厚铜图形电镀、脉冲电镀、HDI 等关键工艺形成一定技术储备，为项目后续工艺导入提供了基础条件。高端高速 PCB 制造涉及低损耗材料、多次压合、高精度钻孔、激光微孔、背钻控制、填充电镀、精细线路、阻抗控制和可靠性检测等环节，公司现有技术储备与目标产品之间仍存在进一步验证和提升空间，但已具备从既有 PCB 制造体系向高多层板、高阶 HDI 板方向延伸的基础。

3、建设场地和工程实施条件具备可行性

项目拟在依顿电子现有中山园区内实施，利用现有土地建设专业化智能厂房，不涉及新增土地购置，有利于降低项目前期用地协调难度，提高存量土地利用效率。项目在现有园区内建设，有利于依托既有管理体系、公辅资源、人员组织和供应链协同基础，缩短建设协调半径。结合项目已明确的厂房规模、产品规划、产能安排和建设周期，项目工程方案具备进一步深化设计和组织实施的基础条件。

4、人才队伍和组织保障具备可行性

依顿电子深耕 PCB 行业 20 余年，已形成内部骨干积累与外部专业人才引进相结合的人才基础。公司现有员工 5000 余人，核心管理层和技术骨干具备较长时间的 PCB 行业从业经验，对 PCB 全流程工艺、制造运营和质量管理具有一定理解和实践基础。围绕本项目实施，公司可依托既有运营经验，抽调内部骨干组建新工厂管理团队，并通过外部引进方式补充高端 PCB 建厂、产品管理、工艺技术和运营管理人才。公司已具备一定人才储备和组织基础，后续仍需围绕客户认证、设备调试、工艺爬坡、质量追溯和数字化运行等重点环节，进一步完善专项团队和培训机制。

（二）补充流动资金项目

公司将严格按照中国证监会、上交所颁布的相关规定及《募集资金管理制度》，建立募集资金专项存储及使用管理制度，根据业务发展需要，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排该部分资金投放的方向、进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用。在资金支付环节，公司将严格按照财务管理制度和资金审批权限进行使用。

总之，本次公司拟用部分募集资金补充流动资金符合相关政策和法律法规规定，符合公司目前的实际情况和业务发展需求，有助于增强公司的抗风险能力，有利于公司的经营业绩提升和业务的长远发展。

五、本次向特定对象发行 A 股股票对公司经营管理、财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

公司本次发行募集资金扣除发行费用后拟用于“高端印制电路板智能制造项目”和“补充流动资金项目”，本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合未来公司整体战略发展方向以及国家相关产业政策，对公司未来发展战略具有积极作用。募投项目的建设有利于扩充公司高端产品品类、扩大公司业务规模，巩固和提高公司行业地位，增强市场影响力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

（二）对公司财务状况的影响

本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成投产后，公司主要产品产能将得到较大幅度提升，从而带动主营业务收入与净利润进一步提升，提高公司盈利能力。但本次发行募集资金到位后，由于募投项目的建成投产并产生效益需要一定时间，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能受到一定程度的影响。此外，本次发行后，公司总资产、净资产规模均将有所增加，财务结构将更趋优化，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

六、可行性分析结论

综上所述，公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目与公司主营业务密切相关，符合国家产业政策和公司发展的需要，具有必要性和可行性。公司投资项目实施后，将进一步增强公司的经营实力，给公司整体带来良好的经济效益和社会效益，符合公司及全体股东的利益。

广东依顿电子科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月七日